



平成 27 年 10 月 28 日

各 位

上場会社名	T O W A 株式会社
代 表 者	代表取締役社長 岡田 博和
コード番号	6315 (東証 1 部)
問合せ先責任者	執行役員経営企画本部長 蒲生 喜代重
	TEL (075) 692 - 0251

## 連結子会社における事業譲受に関するお知らせ

当社の連結子会社である T O W A 韓国株式会社(以下、SAMSUNG 社)の連結子会社である SEMES Co.,Ltd.(以下、SEMES 社)のモールディング事業を譲受いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 事業譲受の目的

SEMES 社は韓国最大の半導体製造装置メーカーであり、モールディング事業については、過去に当社が SAMSUNG 社と共同出資して設立した SECRON Co.,Ltd.(旧社名：韓国 T O W A 株式会社。SAMSUNG 社と協議の結果、2011 年に合弁解消し株式譲渡に合意)が吸収合併され発足した事業であります。

業界のリーディングカンパニーである当社が再び譲受することで、新たな事業機会の創出やシナジー効果が期待されると考えております。

今後も当社は、モールディング事業の売上伸張を図るとともに、新たな市場を創造すべく、基盤強化・成長戦略を積極的に進めてまいります。

#### 2. 事業譲受の内容

SEMES 社が営むモールディング事業

(半導体製造装置および精密金型の製造、販売、改造修理、アフターサービス)

※事業譲受後は、現在 SEMES 社がモールディング事業を行っている工場で営業いたします。

#### 3. 事業譲受の日程

平成 27 年 10 月 15 日 契約締結日

平成 27 年 10 月 27 日 事業譲受日

4. モールド事業譲渡元会社の概要

(1) 名 称	SEMES Co., Ltd.	
(2) 所 在 地	大韓民国忠清南道天安市西北区稷山邑 4 産団 5 ギル 77	
(3) 代表者の役職・氏名	代表理事 キム ヨンシク	
(4) 事 業 内 容	半導体製造装置、FPD 製造装置の製造・販売	
(5) 資 本 金	11,866 百万ウォン	
(6) 設 立 年 月	1993 年 1 月	
(7) 大株主及び持株比率	Samsung Electronics Co., Ltd. 91.5%	
(8) 上 場 会 社 と 当該会社との関係	資 本 関 係	該当事項はありません。
	人 的 関 係	該当事項はありません。
	取 引 関 係	該当事項はありません。

5. 譲受事業の承継会社（連結子会社）の概要

(1) 名 称	TOWA韓国株式会社	
(2) 所 在 地	大韓民国ソウル特別市永登浦区国会大路 750 金山ビル 7 階 704 号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表理事 韓 相倫（当社社員）	
(4) 事 業 内 容	半導体製造装置の販売	
(5) 資 本 金	2,600 百万ウォン	
(6) 設 立 年 月	2013 年 4 月	
(7) 大株主及び持株比率	TOWA株式会社 100%	

6. 今期の業績見通しに与える影響について

本件による平成 28 年 3 月期の業績への影響につきましては、軽微であります。

以 上